

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 12/12/2023 | Edição: 235 | Seção: 1 | Página: 104

Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Gabinete do Ministro

PORTARIA INTERMINISTERIAL MDIC/MCTI Nº 33, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2023

Altera o Processo Produtivo Básico - PPB para Etiqueta Inteligente ("Smart Label") e Dispositivo de Identificação por Radiofrequência ("RFID"), industrializados na Zona Franca de Manaus.

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, no § 1º do art. 2º, no art. 4º e nos arts. 11 a 18 do Decreto nº 10.521, de 15 de outubro de 2020, e considerando o que consta no processo nº 19687.103981/2023-05, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, resolvem:

Art. 1º O Processo Produtivo Básico do produto ETIQUETA INTELIGENTE ("SMART LABEL") e DISPOSITIVO DE IDENTIFICAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA ("RFID"), industrializados na Zona Franca de Manaus, passa a ser composto pelas etapas e respectivas pontuações relacionadas na tabela constante do Anexo desta Portaria Interministerial.

§ 1º Os pontos totais serão atribuídos a cada etapa de produção realizada, conforme o disposto no Anexo, sendo que a empresa deverá acumular no mínimo 66 (sessenta e seis) pontos por ano-calendário.

§ 2º Excepcionalmente para os anos de 2021 até 2024, os pontos totais a que se refere o parágrafo 1º deste artigo deverão acumular, no mínimo, os seguintes valores por ano-calendário:

I - para o ano de 2021: 30 (trinta) pontos; e

II - para os anos de 2022 até 2024: 36 (trinta e seis) pontos.

§ 3º A meta de 36 (trinta e seis) pontos estabelecida no inciso II do §2º deste artigo poderá ser mantida para os anos posteriores, desde que atendidas as duas condições a seguir, concomitantemente:

I - realização do projeto, prototipagem e teste da antena do inlay no País; e

II - que o wafer, utilizado no circuito integrado monolítico, desde que imprescindível aos requisitos do projeto e que não esteja disponível no País, tenha sido cortado exclusivamente por plasma.

§ 4º A realização da etapa produtiva descrita no inciso I do parágrafo 3º deste artigo deverá ser comprovada por meio de evidências concretas, tais como:

I - documentação de abertura, desenvolvimento e encerramento de projeto, com indicação das etapas e profissionais envolvidos no projeto;

II - relatórios de testes;

III - relatórios de ferramentas de gerenciamento e acompanhamento de projeto; e

IV - protótipos desenvolvidos.

§ 5º O projeto de desenvolvimento a que se refere a etapa I do Anexo desta Portaria só será pontuado para produto que atenda às especificações, normas e padrões adotados pela legislação brasileira e cujas especificações, projetos e desenvolvimentos tenham sido realizados no País, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e domiciliados no Brasil e atendam às Portarias específicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI.



Art. 2º O investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA) ao exigido pela legislação a que se refere a etapa II do Anexo desta Portaria deverá ser aplicado, na Amazônia Ocidental ou no Estado do Amapá, em programas e projetos de interesse nacional nas áreas de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento na Amazônia - CAPDA.

§ 1º O investimento a que se refere o caput deste artigo deverá ser calculado sobre o faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização com fruição do benefício fiscal, do produto a que se refere esta Portaria, deduzidos os tributos incidentes nesta operação.

§ 2º A comprovação do investimento em PD&IA deverá ser apresentada de forma discriminada junto com o relatório descritivo referente à obrigação estabelecida na Lei nº 8.387, de 30 de dezembro de 1991.

§ 3º Para efeito do disposto no caput deste artigo, serão considerados como aplicação em atividades de PD&IA do ano-calendário os dispêndios correspondentes à execução de tais atividades realizadas até 31 de março do ano subsequente.

Art. 3º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada por meio de portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 4º Ficam revogadas a Portaria Interministerial SEPEC/ME/SEXEC/MCTIC nº 11.922, de 05 de outubro de 2021 e a Portaria Interministerial SEPEC/ME/SEXEC/MCTIC nº 10.472, de 07 de dezembro de 2022.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

LUCIANA BARBOSA DE OLIVEIRA SANTOS
Ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação



ANEXO

| Etapa | Descrição da etapa produtiva | Pontos Totais |
|-------|---|---------------|
| I | Projeto de Desenvolvimento no País - Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTIC nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, ou Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018. | 8 |
| II | Investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA), valendo 3 pontos para cada 1% investido, limitado a 9 pontos. | 9 |
| III | Desenvolvimento do software embarcado de baixo nível (firmware) utilizado na gravação do circuito integrado. | 2 |
| IV | Processamento físico-químico das lâminas do wafer. | 26 |
| V | Corte do wafer, encapsulamento (quando aplicável) e teste dos circuitos integrados monolíticos. | 38 |
| VI | Impressão por qualquer meio; tratamento eletroquímico ou químico; vaporização; corte ou deposição química de metal do circuito condutivo da antena sob o substrato. | 16 |
| VII | Montagem e soldagem e/ou colagem do circuito integrado no substrato da antena. | 7 |
| VIII | Fabricação e aplicação do material de base laminado com adesivo e liner (material autoadesivo - processo de laminação). | 10 |
| IX | Aplicação do adesivo e do papel ou filme antiaderente (liner) da parte inferior do substrato ou laminação do conjunto circuito integrado/antena em sua base, formando a etiqueta e/ou tag inteligente (conversão). | 7 |
| X | Teste da etiqueta/tag inteligente por meio de comunicação por rádio frequência, podendo ser inline ou off-line. | 5 |
| XI | Gravação da memória do chip (encoding) e configuração das etiquetas ou tag inteligentes. | 1 |
| | TOTAL | 129 |
| | META | 66 |